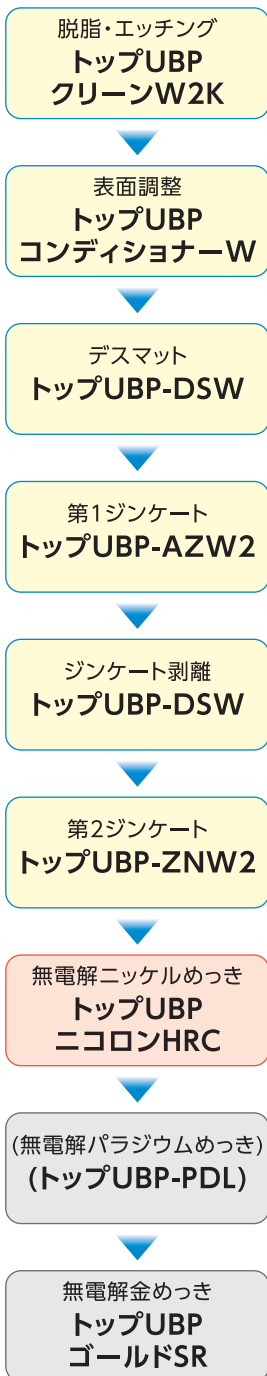


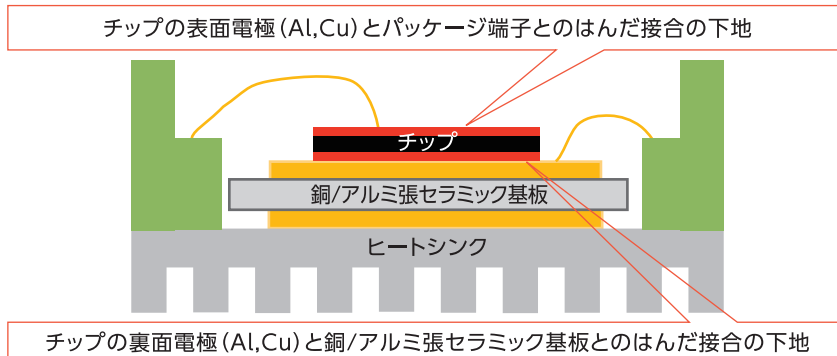
トップUBPプロセスW

ウエハ上のアルミニウム電極用 UBM形成

- ジンケートが緻密に析出し、めっき平滑性に優れる
- アルミスパッタ膜の局部腐食を抑制する前処理プロセス
- 無電解ニッケル皮膜は、400℃の熱処理後においても耐クラック性に優れる

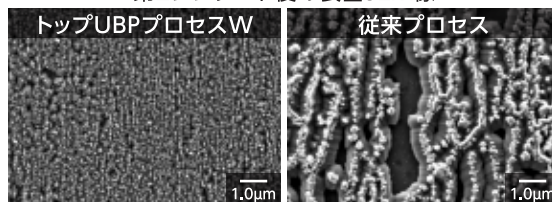


パワーデバイスへの使用例

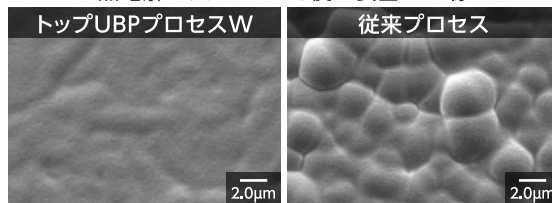


アルミニウム電極上に 均一な皮膜を形成

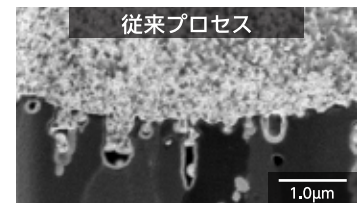
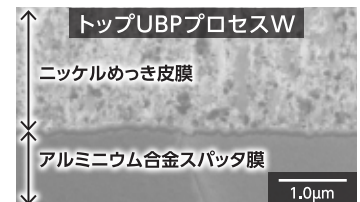
第2ジンケート後の表面SEM像



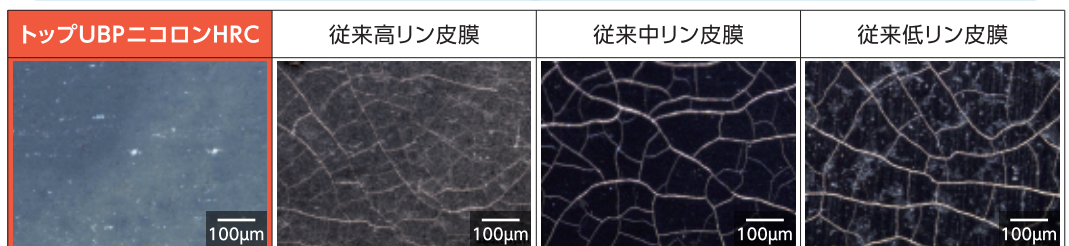
無電解ニッケルめっき後の表面SEM像



アルミスパッタ膜の 局部腐食を抑制



耐クラック性に優れる



エリクセン塗膜強度試験機による押し込み試験後の外観比較 (ニッケル膜厚: 3μm 押し込み幅: 0.5mm)
熱処理: 400℃ 30分

400℃においても耐クラック性に優れる